

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-016

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月18日、2022年4月13日召开了第五届董事会第二十七次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币76亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币55亿元（其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币52.25亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币2.75亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整）。具体内容详见公司于2022年3月22日、2022年4月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告

二、项目贷款基本情况

为了满足全资子公司四川天赐高新材料有限公司（以下称“四川天赐”）“年产30万吨电解液项目”建设资金需求，公司于2023年2月22日召开了第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的议案》，同意四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行广州分行”）申请不超过人民币3.5亿元的项目贷款额度，用于“年产30万

吨电解液项目”建设，期限为五年（以具体签订的合同为准），由公司为本笔项目贷款提供连带责任保证担保。具体情况如下：

公司	银行	额度	用途	担保情况	有效期
四川天赐	招商银行 广州分行	3.5 亿元	用于“年产 30 万吨 电解液项目”建设	四川天赐使用该 授信时，需由公 司提供连带责任 担保	5 年（以具体 签订的合同为 准）

授权公司及子公司法定代表人签署与上述项目贷款事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总金额为 45.77 亿元（含本次董事会审议额度），公司对子公司的担保额度合计人民币 29.75 亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度为人民币 28.8 亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度为人民币 0.95 亿元。本次董事会审议的项目贷款额度占用公司 2021 年度授信额度，在 2021 年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。

本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次项目贷款担保情况

关于全资子公司四川天赐向招商银行申请不超过人民币 3.5 亿元项目贷款的担保

1、担保情况

四川天赐使用该授信时，需由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3.5 亿元。

2、被担保人基本情况

公司名称：四川天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 1 月 11 日

注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段 68 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：

单位：万元

四川天赐	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	4,393
总负债	61
净资产	4,333
四川天赐	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0
净利润	-67

备注：四川天赐于 2022 年 1 月 11 日成立

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为 0 元，公司对子公司的担保额度合计人民币 29.75 亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度为人民币 28.8 亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度为人民币 0.95 亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日